

3月10日(火)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション 時間	回路・実装設計技術 & 高速高周波・電磁特性技術1 座長:大島 真平 (小山工業高等専門学校)	材料技術1 座長:大久保 利一 (サーネットワーク)	3D・チップレット技術1 座長:福島 詩奈 (東北大)	生成AI 実装技術1 座長:中上 京治 (ダイヤセブ)
10:00 10A1-1 (0020)	10B1-1 (0026)	10C1-1 (0003)	10D1-1 (0067)	半導体パッケージ内に形成される異種樹脂界面の安定化プロセス 石田 駿 (九州大学)
10:15 10A1-2 (0105)	10B1-2 (0041)	10C1-2 (0110)	10D1-2 (0081)	チップレット技術による実装 市場分析からみる業界動向 < Low Dk / Low Df 材料 > 青木 正光 (日本環境技術推進機構)
10:30 10A1-3 (0106)	10B1-3 (0042)	10C1-3 (0070)	10D1-3 (0037)	横層構造によるストリップ線路を用いたカルテ 銅錫を用いた銅ナノ粒子ベースの低温接合 山田 駿也 (大陽日酸)
10:45 10A1-4 (0075)	10B1-4 (0052)	10C1-4 (0047)	10D1-4 (0145)	多層無線システム向けのマイクロストリップ ブレーフの設計 徐 振豪 (電気通信大学)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
セッション 時間	回路・実装設計技術 & 高速高周波・電磁特性技術2 座長:松崎 徹 (九州工業大学)	材料技術2 座長:田中 俊平 (日東電工)	3D・チップレット技術2 座長:安田 清和 (大阪大)	生成AI 実装技術2 座長:中上 京治 (ダイヤセブ)
11:15 10A2-1 (0121)	10B2-1 (0064)	10C2-1 (0057)	10D2-1 (0055)	集積素子を用いたBPFと整合回路の統合 設計法 大島 真平 (小山工業高等専門学校)
11:30 10A2-2 (0027)	10B2-2 (0113)	10C2-2 (0115)	10D2-2 (0056)	多層基板上に構築したストリップ接合器による Q向の検証 藤井 俊輔 (九州大学)
11:45 10A2-3 (0127)	10B2-2 (0096)	10C2-3 (0053)	10D2-3 (0040)	チップ素子, MSL構造を用いたトリプル ケーブルの設計に関する検討 松木 淳一郎 (電気通信大学)
12:00 10A2-4 (0076)	10C2-4 (0031)	10D2-4 (0046)		可変ビエータス移相器における位相制御電圧の シミュレーション実測の整合性に関する検討 吉田 健人 (電気通信大学)
12:15	昼食 12:15~13:15 (60分)			
セッション 時間	B会場使用不可 12:00~13:35			
13:15 10A3-1 (0025)	10C3-1 (0007)	10D3-1 (0051)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術3 座長:川上 雄士 (大阪工業大学)
13:30 10A3-2 (0107)	10C3-2 (0008)	10D3-2 (0066)		8GHz 帯偏波UWBストアアンテナの開発 本田 敦士 (九州大学)
13:45 10A3-3 (0022)	10C3-3 (0068)	10D3-3 (0019)		反射角制御型ワーフェスの構造設計と電波 放射特性への応用 Haitao LI (九州大学)
14:00 10A3-4 (0061)	10C3-4 (0133)	10D3-4 (0186)		第6世代移動通信システム用7GHz帯透明電 磁シールドの検討 佐藤 潤次 (東京芸大)
14:15 休憩 14:15~14:30 (15分)	10C3-5 (0136)	10D3-5 (0083)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術4 座長:五島雄輔 健吾 (岡山大学)
14:30 10A4-1 (0023)	10C4-1 (0126)	10D4-1 (0066)		UHF帯CMOSイネルギーハーベスティング回路 の設計 SUN YUCHEN (九州大学)
14:45 10A4-2 (0021)	10C4-2 (0134)	10D4-2 (0058)		地上波送受、LTE、Wi-Fi対応FCP共用差動型RFI ネルギーハーベスティング回路の設計と実証 中瀬 海斗 (九州大学)
15:00 10A4-3 (0073)	10C4-3 (0134)	10D4-3 (0058)		整流器のACアダプタを使用した2MHz磁気結合 整流器WPTシステムのミニレーション 菊地 秀雄 (群馬大学)
15:15 10A4-4 (0077)	10C4-4 (0116)	10D4-3 (0018)		複数のSDRの同期処理に関する検討 川上 雅士 (大阪工業大学)
15:30 10A5-1 (0120)	10C4-4 (0098)	10D4-4 (0131)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術5 座長:室賀 翔 (東北大)
16:00 10A5-2 (0033)	10C4-4 (0090)	10D4-5 (0131)		電磁界シミュレーションによる複数誘電率 を推定する近似的方法に関する検討 松浦 弘樹 (電気通信大学)
16:15 10A5-3 (0050)	10C4-4 (0097)	10D4-5 (0131)		DDR Fly-by-wireにおけるワイヤレスシグナル 短縮構造と波形品質に与える影響 濱木 信朗 (日立製作所)
16:30 10A5-4 (0093)	10C4-5 (0059)	10D4-5 (0131)		超広帯域双方の吸収コモンモードフィルタの設 計と波形の測定 成島 章太 (電気通信大学)
16:45				

3月11日(水)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション 時間	回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術6 座長:森 伸友 (産業技術総合研究所)	3D・チップレット技術1 座長:福島 詩奈 (東北大)	生成AI 実装技術1 座長:中上 京治 (ダイヤセブ)	MES2025受賞講演 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所)
10:00 11A1-1 (0016)	11B1-1 (0049)	11C1-1 (0099)	11D1-1 (0042)	信頼性に優れるターボドライバによるSi Deep RIEのマイ クローリング効果 小島 龍馬 (コネクティクス)
10:15 11A1-2 (0033)	11B1-2 (0071)	11C1-2 (0043)	11D1-2 (0143)	半導体ICへのEMIテルマ化技術適用と精度検 証 Gallegos Alessandra (京都先端科学大学)
10:30 11A1-3 (0124)	11B1-3 (0088)	11C1-3 (0095)	11D1-3 (0144)	信頼性による高感度誘導センサのためのナノ銀焼 結膜の破壊に及ぼす銅粒子添加の効果 程 淳子 (群馬大学)
10:45 11A1-4 (0103)	11B1-4 (0111)	11C1-4 (0111)	11D1-4 (0145)	市場分析からみる業界動向 < Low Dk / Low Df > 市場分析によるチップリード時間の検討 田中 慶大 (東京大)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
セッション 時間	回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術7 座長:竹内 魁 (東北大)	3D・チップレット技術2 座長:若生 直樹 (電磁材料研究所)	生成AI 実装技術2 座長:木下 遼太 (住友ベーライト)	MES2025受賞講演 (各20分) 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所)
11:15 11A2-1 (0015)	11B2-1 (0123)	11C2-1 (0153)	11D2-1 (0146)	MEMS技術を用いたシリコン製ペーパーチャンバー による電荷認識センサの開発 佐々木 深太 (東北大)
11:30 11A2-2 (0074)	11B2-2 (0132)	11C2-2 (0153)	11D2-2 (0147)	VOLOによる高感度誘導センサの開発 柳澤 直也 (東京理学大学)
11:45 11A2-3 (0091)	11B2-3 (0118)	11C2-2 (0100)	11D2-3 (0148)	VOLOによる高感度誘導センサの開発 佐藤 遼一 (東北大)
11:50 11A2-4 (0148)	11B2-4 (0138)	11C2-3 (0138)	11D2-4 (0149)	活性化技術による表面活性化による大気中常温チップ接合 松原 春生 (九州大学)
12:00 11A2-5 (0140)	11B2-5 (0140)	11C2-4 (0150)	11D2-5 (0151)	活性化技術による表面活性化による大気中常温チップ接合 村中 潤平 (九州大学)
12:15	昼食 12:15~13:15 (60分)			
セッション 時間	B会場使用不可 12:00~13:35			
13:15 10A3-1 (0025)	10C3-1 (0007)	10D3-1 (0051)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術3 座長:川上 雄士 (大阪工業大学)
13:30 10A3-2 (0107)	10C3-2 (0008)	10D3-2 (0066)		8GHz 帯偏波UWBストアアンテナの開発 本田 敦士 (九州大学)
13:45 10A3-3 (0022)	10C3-3 (0068)	10D3-3 (0019)		反射角制御型ワーフェスの構造設計と電波 放射特性への応用 Haitao LI (九州大学)
14:00 10A3-4 (0061)	10C3-4 (0133)	10D3-4 (0186)		第6世代移動通信システム用7GHz帯透明電 磁シールドの検討 佐藤 潤次 (東京芸大)
14:15 休憩 14:15~14:30 (15分)	10C3-5 (0136)	10D3-5 (0083)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術4 座長:五島雄輔 健吾 (岡山大学)
14:30 10A4-1 (0023)	10C4-1 (0126)	10D4-1 (0066)		UHF帯CMOSイネルギーハーベスティング回路 の設計 SUN YUCHEN (九州大学)
14:45 10A4-2 (0021)	10C4-2 (0134)	10D4-2 (0058)		地上波送受、LTE、Wi-Fi対応FCP共用差動型RFI ネルギーハーベスティング回路の設計と実証 中瀬 海斗 (九州大学)
15:00 10A4-3 (0073)	10C4-3 (0134)	10D4-3 (0058)		整流器のACアダプタを使用した2MHz磁気結合 整流器WPTシステムのミニレーション 菊地 秀雄 (群馬大学)
15:15 10A4-4 (0077)	10C4-4 (0116)	10D4-4 (0018)		複数のSDRの同期処理に関する検討 川上 雅士 (大阪工業大学)
15:30 10A5-1 (0120)	10C4-4 (0098)	10D4-5 (0131)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術5 座長:室賀 翔 (東北大)
16:00 10A5-2 (0033)	10C4-4 (0090)	10D4-5 (0131)		電磁界シミュレーションによる複数誘電率 を推定する近似的方法に関する検討 松浦 弘樹 (電気通信大学)
16:15 10A5-3 (0050)	10C4-4 (0097)	10D4-5 (0131)		DDR Fly-by-wireにおけるワイヤレスシグナル 短縮構造と波形品質に与える影響 濱木 信朗 (日立製作所)
16:30 10A5-4 (0093)	10C4-5 (0059)	10D4-5 (0131)		超広帯域双方の吸収コモンモードフィルタの設 計と波形の測定 成島 章太 (電気通信大学)
16:45	昼食 12:15~13:15 (60分)			
セッション 時間	B会場使用不可 12:00~13:35			
13:15 10A3-1 (0025)	10C3-1 (0007)	10D3-1 (0051)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術6 座長:高橋 修司 (国研)
13:30 10A3-2 (0107)	10C3-2 (0008)	10D3-2 (0066)		サーマルマネージメント & パワーエレクトロ ニクス実装1 生成AI 実装技術3 座長:高橋 修司 (国研)
13:45 10A3-3 (0022)	10C3-3 (0068)	10D3-3 (0191)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術7 座長:竹内 魁 (東北大)
14:00 10A3-4 (0061)	10C3-4 (0133)	10D3-4 (0186)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術8 座長:高橋 修司 (国研)
14:15 休憩 14:15~14:30 (15分)	10C3-5 (0136)	10D3-5 (0083)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術9 座長:高橋 修司 (国研)
14:30 10A4-1 (0023)	10C4-1 (0126)	10D4-1 (0066)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術10 座長:高橋 修司 (国研)
14:45 10A4-2 (0021)	10C4-2 (0134)	10D4-2 (0058)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術11 座長:高橋 修司 (国研)
15:00 10A4-3 (0073)	10C4-3 (0134)	10D4-3 (0058)		回路・実装設計技術 & 高速高周波・電 磁特性技術12 座長:高橋 修司 (国研)
15:15 10A4-4 (0077)	10C4-4 (011			